

Dell PowerEdge Rack-Server

Kurzanleitung

Dell PowerEdge Rack-Server unterstützen Sie bei der Erstellung einer modernen Infrastruktur, die IT-Probleme minimiert und geschäftliche Erfolge erzielt. Diese Kurzanleitung (Quick Reference Guide, QRG) enthält eine komprimierte Ansicht unseres gesamten Rack-Server-Portfolios.

Rack-Server	R470	R570	R670	R770	R770AP	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R4715	R5715
Wichtige Attribute	Speziell entwickelt für maximale Effizienz und Erschwinglichkeit mit optimierten Servern mit einem Sockel, die starke Performance für cloudbasierte Web- und Anwendungs-Microservices, Datendienste, Virtualisierung und Scale-out-Datenbanken bieten.	Speziell entwickelt für maximale Effizienz und Erschwinglichkeit mit optimierten Servern mit einem Sockel, die starke Performance für cloudbasierte Web- und Anwendungs-Microservices, Datendienste, Virtualisierung und Scale-out-Datenbanken bieten.	Offenes Ökosystem, das für Compute-Workloads optimiert und auf die Leistungsoptimierung und eine ausgewogene Performance für Bereitstellungen mit hoher Dichte, cloudnative Anwendungen und All-Flash-SDS ausgelegt ist.	Offenes Ökosystem, das für Compute-Workloads optimiert ist und maximale Performance mit optimierter Leistung für Virtualisierung und Microservices, cloudnative Anwendungen und umfangreiche Analysen bietet.	Speziell entwickelt für Unternehmensumgebungen, die sowohl Leistung als auch Ausfallsicherheit erfordern. Er bietet die erforderliche Skalierung, um enorme Workloads auszuführen, die Effizienz zum Senken der Betriebskosten und die Sicherheit zum Schutz kritischer Daten. Dadurch wird er zur Serverbasis für Enterprise-Innovationen.	Passende Dimensionierung für Arbeitsspeicher und Storage-Dichte	Verbesserte Performance – besserer Nutzen	Bahnbrechende Performancedichte	Bahnbrechende, skalierbare Performance	Entwickelt für die Unterstützung von Workloads mit hoher Storage-Dichte	Entwickelt für starke Performance, Flexibilität und Effizienz für kleine und mittelständische Unternehmen	Entwickelt für starke Performance, Flexibilität und Effizienz für kleine und mittelständische Unternehmen
Ziel-Workloads	Virtualisierung, Scale-out-Datenbank, Big Data und Analysen, High Performance Compute und Edge Compute	Virtualisierung mit mittlerer Dichte, Scale-out-Datenbanken, Big Data und Analysen, VDI, High Performance Compute und Software Defined Storage.	Virtualisierung, Cloud-native Anwendungen, All-Flash-SDS, Hyperscale-Workloads und Scale-out-Datenbanken	Virtualisierung, Inferencing künstlicher Intelligenz, Cloud-native Anwendungen, Hyperscale-Workloads und Scale-out-Datenbanken.	High-Performance-Computing (HPC), Virtualisierung der nächsten Stufe und datenintensive Analysen	Data Analytics, Dense Virtualization und Software Defined Storage	Data Analytics, Dense Virtualization und Software Defined Storage	High Performance Computing (HPC), virtuelle Desktopinfrastruktur (VDI) und Virtualisierung	High Performance Computing (HPC), virtuelle Desktopinfrastruktur (VDI) und Virtualisierung	Objektspeicher	Datenanalysen, Virtualisierung, Scale-Out-Datenbanken, Edge-Computing	Virtualisierung, mittlere VM-Dichte oder VDI, Videoüberwachung im Einzelhandel, Datenanalysen
Prozessortypen	1 Intel® Xeon® 6 E-Core Prozessor mit bis zu 144 Cores oder 1 Intel® Xeon® 6 P-Core Prozessor mit bis zu 86 Cores und R1S-Option		2 Intel® Xeon® 6 E-Core Prozessor mit bis zu 144 Cores oder 2 Intel® Xeon® 6 P-Core Prozessoren mit bis zu 86 Cores		2 Intel® Xeon® 6 Prozessoren der 6900 Serie mit P-Cores mit bis zu 128 Cores	Ein AMD EPYC™ Prozessor der 5. Generation der 9005 Serie, bis zu 160 Cores		Zwei AMD EPYC™ Prozessoren der 5. Generation der 9005 Serie, bis zu 192 Cores pro Prozessor		Zwei AMD EPYC™ Prozessoren der 5. Generation der 9005 Serie, bis zu 192 Cores	Ein AMD EPYC™ Prozessor der 5. Generation der 9005 Serie, bis zu 32 Cores	
DDR5-DIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	16 (4 TB)	16 (4 TB)	32 (8 TB)		24 (3 TB)	24 (6 TB)	24 (6 TB)	24 (6 TB)	24 (6 TB)	24 (3 TB)	24 (1,5 TB)	24 (1,5 TB)
Festplattenlaufwerke bis:	4 x 3,5" 8 x 2,5" 10 x 2,5" 8 x E3.S / 16 x E3.S 2 x E3.S (hinten)	8 x 2,5" 12 x 3,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 8 x E3.S / 16 x E3.S / 32 x E3.S 4 x E3.S (hinten)	8 x 2,5" 10 x 2,5" 8 x E3.S / 16 x E3.S / 20 x E3.S 2 x E3.S (hinten)	8 x 2,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 8 x E3.S/16 x E3.S (FIO-Konfiguration) 32 x E3.S / 40 x E3.S 4 x E3.S (hinten)	8 x 2,5" 16 x 2,5" 32 x E3.S	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll/U.2 10 x 2,5" 16 x E3.S / 20 x E3.S 2 x E3.S (hinten)	2 x U.2 8 x 2,5 Zoll/U.2 12 x 3,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 8 x E3.S / 16 x E3.S / 32 x E3.S / 40 x E3.S	4 x 3,5 Zoll 4 x U.2 8 x 2,5" 10 x 2,5" 24 x 2,5 Zoll 8 x E3.S / 16 x E3.S / 20 x E3.S 2 x E3.S (hinten)	8 x 2,5 Zoll/U.2 12 x 3,5" 16 x 2,5" 24 x 2,5" 8 x E3.S / 16 x E3.S / 32 x E3.S / 40 x E3.S	24 x 2,5" U.2 Gen5	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll/U.2	12 x 3,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll
NVMe Laufwerke bis zu:	16	32	22	44	32	22	40	22	40	24	8	k. A.
Gen5 PCIe-Steckplätze bis zu:	4	4.	3	8	5	3	8	3	8	5*	3	4.







Rack-Server	R470	R570	R670	R770	R770AP	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R4715	R5715
Gen4 PCIe-Steckplätze bis zu:	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Accelerator-Unterstützung bis zu:	4 x 75 W SW	3 x 400 W DW oder 4 x 75 W SW	3 x 75 W SW	2 x 450 W DW oder 6 x 75 W SW	k. A.	3 x 75 W SW	3 x 450 W DW oder 6 x 75 W SW	3 x 75 W SW	2 x 450 W DW oder 6 x 75 W SW	k. A.		
Rack-Höhe (U)	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2		
Integrierte Sicherheit	Kryptografisch signierte Firmware, Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), Secure Boot, Secured Component Verification (Hardwareintegritätsprüfung), Silicon Root of Trust, Secure Erase, Systemsperre (erfordert iDRAC10 Enterprise oder Datacenter), TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, Gehäuseeingriffserkennung					Kryptografisch signierte Firmware, Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), Secure Boot, Secured Component Verification (Hardwareintegritätsprüfung), Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre, TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, AMD Secure Memory Encryption (SME), AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV), Gehäuseeingriffserkennung						





Hinweis: * Funktionen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind bei der Produkteinführung möglicherweise nicht verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.

Rack-Server	R760	R660	R7625	R6625	R7615	R6615	R660xs	R760xs	HS5610***	HS5620***
Wichtige Attribute	Bietet Leistung und Vielseitigkeit für anspruchsvolle Anwendungen	Bietet Leistung und Vielseitigkeit für anspruchsvolle Anwendungen	Bahnbrechende Leistung	Bahnbrechende Leistung	Hohe Leistung und Skalierbarkeit	Spitzenleistung und hervorragende Gesamtbetriebskosten	Richtige Größe für die gängigsten IT-Anwendungen	Richtige Größe für die gängigsten IT-Anwendungen	Offene Umgebung, optimiert für Rechen-Workloads	Offene Umgebung, optimiert für Workloads mit hoher Speicherdichte
Ziel-Workloads	Standardisierung gemischter Workloads, Datenbank und Analysen, virtuelle Desktopinfrastruktur	Virtualisierung und Datenbankanalysen mit hoher Dichte, Standardisierung gemischter Workloads	High Performance Computing (HPC), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Virtualisierung	High Performance Computing (HPC), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Virtualisierung	Software Defined Storage (SDS), Virtualisierung, Datenanalysen	Virtualisierung, Hyper-Converged Infrastructure (HCI), Network Functions Virtualization (NFV)	Virtualisierung, Cloud, Scale-Out-Datenbank, High Performance Computing (HPC)	Virtualisierung, Software Defined Storage, VM oder VDI mit mittlerer Dichte	Virtualisierung, Scale-Out-Datenbank, Software Defined Storage Node	Virtualisierung, mittlere VM-Dichte oder VDI, Software Defined Storage Node
Prozessortypen	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation mit bis zu 56 Cores pro Prozessor oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 64 Cores pro Prozessor		Zwei AMD EPYC™ Prozessoren der 4. Generation der 9004 Serie, bis zu 128 Cores pro Prozessor		Ein AMD EPYC™ Prozessor der 4. Generation der 9004 Serie, bis zu 128 Cores		2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessor der 5. Generation mit bis zu 28 Cores oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation mit bis zu 32 Cores pro Prozessor		2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessor der 5. Generation mit bis zu 32 Cores oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation mit bis zu 32 Cores pro Prozessor	
DDR5-DIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	32 (8 TB)		24 (6 TB)		12 (3 TB)		16 (1,5 TB)	16 (1,5 TB)	16 (2 TB)	16 (2 TB)
Festplattenlaufwerke bis zu:	12 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 16 x E3.S 2 x 2,5 Zoll (hinten) 4 x 2,5 Zoll (hinten) 4 x E3.S (hinten)	8 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 14 x E3.S 16 x E3.S 2 x 2,5 Zoll (hinten) 2 x E3.S (hinten)	8 x 3,5 Zoll 12 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll (hinten) 4 x 2,5 Zoll (hinten) 4 x E3.S (hinten)	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 14 x E3.S 16 x E3.S 2 x 2,5 Zoll (hinten) 2 x E3.S (hinten)	8 x 3,5 Zoll 12 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll (hinten) 4 x 2,5 Zoll (hinten) 4 x E3.S (hinten)	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 14 x E3.S 16 x E3.S 2 x 2,5 Zoll (hinten) 2 x E3.S (hinten)	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll (hinten)	12 x 3,5 Zoll 8 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll + 8 x NVMe 2 x 2,5 Zoll (hinten)	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 6 x NVMe 10 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll (hinten)	12 x 3,5 Zoll 8 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll + 8 x NVMe 2 x 2,5 Zoll (hinten)
NVMe Laufwerke bis zu:	24	10	24	10	24	10	10	8	10	8
Gen5 PCIe-Steckplätze bis zu:	4	2	4.	2	4.	2	2	2	2	2
Gen4 PCIe-Steckplätze bis zu:	8	3	8	3	4.	3	3	4.	3	4.
Accelerator-Unterstützung bis zu:	2 x 350W DW oder 6 x 75W SW	3 x 75 W SW	2 x 300W DW oder 6 x 75W SW	3 x 75 W SW	3 x 300W DW oder 6 x 75W SW	3 x 75 W SW	k. A.	2 x 75 W SW	k. A.	2 x 75 W SW
Rack-Höhe (U)	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2
Integrierte Sicherheit	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Alarm bei Gehäuseeinbruch, Secure Boot als Standardsicherheit, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter), Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) und Systemlöschung auf allen Racks.			TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Secure Boot, Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter), AMD Secure Memory Encryption (SME) und AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV)			TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Alarm bei Gehäuseeinbruch, Secure Boot als Standardsicherheit, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter), Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) und Systemlöschung auf allen Racks.			

Hinweis: * Funktionen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind bei der Produkteinführung möglicherweise nicht verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.

*** HS560 und HS5620 werden exklusiv über das Hyperscale Next-Programm für ausgewählte Kunden angeboten.






Rack-Server	R960	R860	R760xa	R760xd2	R360	R260
						
Wichtige Attribute	Extreme Beschleunigung für Business Continuity und Scale-out	Unterstützung geschäftskritischer Core-Workloads mit Rechenleistung mit hoher Dichte	Leistungsstarker, skalierbarer Server für intensive GPU-Anwendungen	Hohe Speicherdichte, schnellerer Abruf und Skalierbarkeit	Optimierte Produktivität, Enterprise-GPU und leistungsstarke Rechenleistung für gängige Geschäftsanwendungen.	Rack-Server mit geringer Tiefe und Filterblende für Near-Edge-KundInnen mit den neuesten Intel® Xeon® Prozessoren der 6300 Serie, DDR5-Arbeitsspeicher, NVMe BOSS und Energy Star 4.0-Netzteil
Ziel-Workloads	Große In-Memory-Datenbanken, Datenanalysen, KI und Virtualisierung, virtuelle Desktopinfrastruktur (VDI)		KI/ML/DL-Training und Inferencing Digitale Zwillinge, Rendern von Grafiken Virtualisierung und VDI-Grafik	Datei- und Objektspeicher, Videoaufnahme und Überwachung, Videostreaming	Zusammenarbeit und Freigabe, E-Mail und Messaging, Datenbank	Zusammenarbeit und Freigabe, E-Mail und Messaging, Near-Edge-Anwendungen
Prozessortypen	4 Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation mit bis zu 60 Cores pro Prozessor und mit optionaler Intel® QuickAssist Technology		2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation, bis zu 56 Cores pro Prozessor oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation, bis zu 64 Cores pro Prozessor	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation, bis zu 32 Cores pro Prozessor oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation, bis zu 28 Cores pro Prozessor	1 Intel® Xeon® Prozessor der 6300 Serie mit bis zu 8 Cores oder 1 Intel® Xeon® Prozessor der E-2400 Serie mit bis zu 8 Cores oder 1 Intel® Pentium Prozessor mit 2 Cores	1 Intel® Xeon® Prozessor der 6300 Serie mit bis zu 8 Cores oder 1 Intel® Xeon® Prozessor der E-2400 Serie mit bis zu 8 Cores oder 1 Intel® Pentium Prozessor mit 2 Cores
DDR5-DIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	64 (16 TB)		32 (8 TB)	16 (1,5 TB)	4 (128 GB)	4 (128 GB)
Festplattenlaufwerke bis:	8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 32 x 2,5 Zoll 16 x E3.S 8 x 2,5 Zoll + 16 x E3.S	8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 8 x E3.S 2 x 2,5 Zoll (hinten)	6 x 2,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 6 x E3.S	12 x 3,5 Zoll (vorderer Schacht) + 12 x 3,5 Zoll (mittlerer Schacht) 2 x 2,5 Zoll oder 4 x 2,5 Zoll oder 4 x 3,5 Zoll oder 4 x E3.S (hinten)	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 6 x 2,5"-SAS/SATA + 2 x 2,5"-NVMe	2 x 3,5 Zoll 6 x 2,5 Zoll 4 x 2,5"-Chip-SATA-SSD (SW-RAID) 4 x 2,5"-Chip-SATA + 2 x 2,5"-NVMe (SW-RAID) 4 x 2,5"-SAS/SATA + 2 x 2,5"-NVMe (HW-RAID)
NVMe Laufwerke bis zu:	24	24	8	4.	2	2
Gen5 PCIe-Steckplätze bis zu:	12	8	12	k. A.	2	k. A.
Gen4 PCIe-Steckplätze bis zu:	k. A.	4	k. A.	5	2	2
Accelerator-Unterstützung bis zu:	4 x 400 W DW	k. A.	4 x 400 W DW oder 12 x 75 W SW	2 x 75 W SW, 1 x 75 W SW + 1 x 150 W SW oder 1 x 180 W DW	1 x 60 W SW	k. A.
Rack-Höhe (U)	4	2	2	2	1	1
Integrierte Sicherheit	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Alarm bei Gehäuseeinbruch, Secure Boot als Standardsicherheit, Silicon Root of Trust, Systemsperrung (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter), Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) und Systemlöschung auf allen Racks.					

Rack-Server	XE7745	XE7740	XE9680L	XE9685L
				
Wichtige Attribute	Die internen GPU-Steckplätze wurden speziell für KI-Inferenzierung, Modelloptimierung und High-Performance Computing entwickelt und sind mit acht zusätzlichen PCIe-Steckplätzen der 5. Generation für Netzwerkkonnektivität kombiniert, wodurch dichte und flexible Konfigurationen mit der doppelten DW PCIe GPU-Kapazität im Vergleich mit Dell PowerEdge R760xa ermöglicht werden.	Die internen GPU-Steckplätze wurden speziell für KI-Inferenzierung, Modelloptimierung und High-Performance Computing entwickelt und sind mit acht zusätzlichen PCIe-Steckplätzen der 5. Generation für Netzwerkkonnektivität kombiniert, wodurch dichte und flexible Konfigurationen mit der doppelten DW PCIe GPU-Kapazität im Vergleich mit Dell PowerEdge R760xa ermöglicht werden.	Herausragende KI-Trainings- und HPC-Performance mit CPUs und GPUs mit direkter Flüssigkeitskühlung in einem 4-HE-Formfaktor	Herausragende KI-Trainings- und HPC-Performance mit CPUs und GPUs mit direkter Flüssigkeitskühlung in einem 4-HE-Formfaktor
Ziel-Workloads	GenAI-Feintuning, GenAI-Inferencing, Verarbeitung natürlicher Sprache, digitale Zwillinge, Agentische KI	GenAI-Feintuning, GenAI-Inferencing, Verarbeitung natürlicher Sprache, digitale Zwillinge, Agentische KI	KI-Training, LLM-Training, Feinabstimmung und umfassende LLM-Inferenz	KI-Training, LLM-Training, Feinabstimmung und umfassende LLM-Inferenz
Prozessortypen	2 AMD EPYC™ 9005 Serie-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 192 Cores pro Prozessor	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 56 Cores pro Prozessor	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 64 Cores pro Prozessor	2 AMD EPYC™ 9005 Serie-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 192 Cores pro Prozessor
DDR5-DIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	24 (3 TB)	24 (3 TB)	32 (4 TB)	24 (3 TB)
Festplattenlaufwerke bis:	8 E3.S	8 E3.S	8 x 2,5"	8 x 2,5"
NVMe Laufwerke bis zu:	-	k. A.	8	8
Gen5 PCIe-Steckplätze bis zu:	8	8	12	12
Gen4 PCIe-Steckplätze bis zu:	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Accelerator-Unterstützung bis zu:	8 x 600W SW oder 16 x 75W SW	8 x 600W SW oder 16 x 75W SW	8 x NVIDIA HGX B200 SXM6-GPUs mit 180 GB und 1.000 W, die vollständig mit der NVIDIA NVLink-Technologie verbunden sind	8 x NVIDIA HGX B200 SXM6-GPUs mit 180 GB und 1.000 W, die vollständig mit der NVIDIA NVLink-Technologie verbunden sind
Rack-Höhe (U)	4	4.	4	4.
Integrierte Racks	k. A.	k. A.	IR5000 erforderlich	IR5000 erforderlich
Integrierte Sicherheit	Kryptografisch signierte Firmware, Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement)*, Secure Boot, Secured Component Verification (Hardwareintegritätsprüfung), Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC10 Enterprise oder Datacenter)*, TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, AMD Secure Memory Encryption (SME), AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV)	Gehäuseeingriffserkennung, kryptografisch signierte Firmware, Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement)*, Secure Boot, Secured Component Verification (Hardwareintegritätsprüfung), Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC10 Enterprise oder Datacenter), TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert	Kryptografisch signierte Firmware, Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), Secure Boot, Secured Component Verification (Hardwareintegritätsprüfung), Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter), TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert	Kryptografisch signierte Firmware, Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), Secure Boot, Secured Component Verification (Hardwareintegritätsprüfung), Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter), TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert

Hinweis: * Funktionen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind bei der Produkteinführung möglicherweise nicht verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.

Dell PowerEdge Rack-Server

Kurzanleitung

Rack-Server	XE9680	XE9640	XE8640	XR7620	XR5610
					
Wichtige Attribute	Kompromisslose beschleunigte KI-Trainingsleistung, Flexibilität der Wahl von H100, 6 HE mit 2 Sockeln und Unterstützung für Umgebungstemperaturen von bis zu 35 °C	Für hohe Dichte optimierte KI- und HPC-Performance mit CPUs und GPUs mit direkter Flüssigkeitskühlung in einem 2-HE-Formfaktor	Schnelleres ML-/DL-Training und höhere HPC-Leistung, 4-HE-Server mit 2 Sockeln, Umgebungstemperatur von bis zu 35 °C, Standardracktiefe	Edge-optimierter 2-HE-Server mit 2 Sockeln und hoher Performance, hoher Kapazität und geringer Tiefe	Hohe Performance, geringe Tiefe, robust, umgekehrte Montage, gefilterte Blende, Betriebstemperaturen von -5 °C bis 55 °C
Ziel-Workloads	Training großer Modelle, Verarbeitung natürlicher Sprache, Empfehlungs-Engines, Conversational AI, Übersetzung, Wirkstoffentdeckung	HPC-Modellierung und -Simulation, seismische Analyse, rechnergestützte Strömungsmechanik, Öl und Gas, KI-/ML-Training, Objekterkennung, Bildklassifizierung	HPC-Modellierung und -Simulation, seismische Analyse, rechnergestützte Strömungsmechanik, Öl und Gas, KI-/ML-Training, Objekterkennung, Bildklassifizierung	Industrielle Automatisierung, Videoanalysen, Point-of-Sale-Analysen, KI-Inferenzen, Aggregation und Analyse von Edge-Ressourcendaten	vRAN, D-RAN, O-RAN, industrielle Automatisierung, Videoanalysen, Point-of-Sale-Analysen, KI-Inferenzen, Aggregation und Analyse von Edge-Ressourcendaten
Prozessortypen	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation, bis zu 56 Cores pro Prozessor oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation, bis zu 56 Cores pro Prozessor	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation, bis zu 56 Cores pro Prozessor oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation, bis zu 56 Cores pro Prozessor	2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation, bis zu 56 Cores pro Prozessor oder 2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation, bis zu 56 Cores pro Prozessor	2 skalierbarer Intel® Xeon® Prozessor der 5. Generation, bis zu 16 Cores pro Prozessor oder 2 skalierbarer Intel® Xeon® Prozessor der 4. Generation, bis zu 32 Cores pro Prozessor	1 skalierbarer Intel® Xeon® Prozessor der 5. Generation, bis zu 16 Cores pro Prozessor oder 1 skalierbarer Intel® Xeon® Prozessor der 4. Generation, bis zu 32 Cores pro Prozessor
DDR5-DIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	32 (4 TB)	• 16 (1 TB) Intel GPU • 8, 16, 32 (2 TB) NVIDIA GPU	32 (4 TB)	16 (1 TB)	8 (1 TB)
Festplattenlaufwerke bis:	8 x 2,5 Zoll 16 x E3.S	4 x 2,5 Zoll	8 x 2,5 Zoll	4 x 2,5 Zoll 8 x E3.S	4 x 2,5 Zoll
NVMe Laufwerke bis zu:	8	4.	8	4.	4
Gen5 PCIe-Steckplätze bis zu:	10	4.	4	2	2
Gen4 PCIe-Steckplätze bis zu:	k. A.	k. A.	k. A.	5	k. A.
Accelerator-Unterstützung bis zu:	8 NVIDIA HGX H100 80 GB 700 W SXM5 GPUs oder NVIDIA HGX H800 8-GPU SXM 80 GB 700 W GPUs, NVIDIA HGX H200 8-GPU SXM 141 GB 700 W GPUs, NVIDIA HGX H20 8-GPU SXM 96 GB 500 W GPUs oder 8 AMD Instinct MI300X 192 GB 750 W OAM GPU oder 8 Intel Gaudi3 128 GB 900 W OAM GPU	4 NVIDIA H100 SXM 7000W NVLINK GPUs oder Intel Data Center Max GPU Serie 1550 OAM 600 W Xelink GPUs	4 NVIDIA HGX H100 80 GB SXM5-GPUs mit 700 W, vollständig vernetzt mit NVIDIA NVLink-Technologie	4 x 150 W SW oder 2 x 300 W DW	2 x 75 W SW
Rack-Höhe (U)	6	2	4.	2	1
Integrierte Racks	Optional: IR5000	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Integrierte Sicherheit	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Alarm bei Gehäuseeinbruch, Secure Boot als Standardsicherheit, Silicon Root of Trust, System Sperre (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter), Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), gesicherte Komponentenverifizierung, Hardwareintegritätsprüfung und Systemlöschung auf allen Racks.				

Hinweis: * Funktionen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind bei der Produkteinführung möglicherweise nicht verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.

Dell PowerEdge Rack-Server

Kurzanleitung

Rack-Server	R750	R750xa	R650	R7525	R6525	R7515	R6515	R750xs	R650xs	R450	R550	XR11	XR12	R350	R250
Wichtige Attribute	Hervorragende Performance für die anspruchsvollsten Workloads	Hohe GPU-Workloads	Hohe Skalierbarkeit, optimierte Workload-Performance	Hohe Leistung und Flexibilität	Intensive Virtualisierung	Hohe Leistung und Skalierbarkeit	Datenverarbeitung mit hoher Dichte	Speziell entwickelter 2-HE-Server für wachsende Scale-Out-Lösungen	Speziell entwickelter, leistungsstarker 1-HE-Server für dichte, schnell wachsende Scale-Out-Lösungen	Wert- und dichteorientiert, entwickelt für universelle IT-Anwendungen	Vielseitig, wertoptimiert, geeignet für Virtualisierung, entwickelt für universelle IT-Anwendungen	Edge-orientiert, mit geringer Tiefe und robust mit Optionen für wechselseitige Montage	Edge-orientiert, mit geringer Tiefe und robust mit Optionen für wechselseitige Montage	Leistungsstarke Leistung in einem 1-HE-Server für Produktivität und datenintensive Anwendungen	Leistungsstarke Rechenleistung für gängige Geschäftsanwendungen und Rationalisierung der Produktivität
Ziel-Workloads	Datenbanken und Analysen, HPC, herkömmliche IT-, VDI-, KI- oder ML-Umgebungen in Unternehmen	KI-, ML- oder DL-Schulung oder Inferenz, HPC- und Virtualisierungsumgebungen	Gemischte Workload-Standardisierung, Datenbanken und Analysen, HFT, herkömmliche IT-, VDI-, HPC-, KI oder ML-Umgebungen in Unternehmen	All Flash SDS, VDI und Datenanalysen	HPC, dicht VDI und Virtualisierung	SDS, Virtualisierung und Datenanalyse	Virtualisierung, HCI und NFV	Virtualisierung, mittlere VM-Dichte oder VDI und Scale-Out-Datenbank-Workloads	Virtualisierungs-, Cloud-, Scale-Out-Datenbank- und High-Performance-Compute-Workloads	Kleine IT-Infrastruktur, leichte VM, typische Workloads für kleine Unternehmen	Kleine IT-Infrastruktur, leichte VM-Dichte, typische Workloads für kleine Unternehmen	Telco/5G (MEC, CDN, vRAN), Militär, Einzelhandel (Analysen – Videoüberwachung/POS/IOT-Aggregation)	Telco/5G (MEC, CDN, vRAN), Militär, Einzelhandel (Analysen – Videoüberwachung/POS/IOT-Aggregation)	Kleine und mittelständische Unternehmen, Remotestandorte/ Zweigstellen, Zusammenarbeit und Freigabe, Datenanalyse- und Virtualisierungs-Workloads	Kleine und mittelständische Unternehmen, Remotestandorte/ Zweigstellen, Zusammenarbeit und Freigabe, E-Mail/ Messaging sowie Datei-/ Druck-Workloads
Prozessortypen	Zwei Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 3. Generation, bis zu 40 Cores pro Prozessor			2 AMD EPYC™-Prozessoren der 2. oder 3. Generation, bis zu 64 Cores pro Prozessor		1 AMD EPYC™-Prozessor der 2. oder 3. Generation, bis zu 64 Cores pro Prozessor		2 skalierbarer Intel® Xeon® Prozessor der 3. Generation, bis zu 32 Cores pro Prozessor		2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation, bis zu 24 Cores pro Prozessor		1 skalierbarer Intel® Xeon® Prozessor der 3. Generation, bis zu 36 Cores pro Prozessor		1 Intel Xeon Prozessoren der E-2300 Serie mit bis zu 8 Cores oder 1 Intel Pentium Prozessor mit bis zu 2 Cores	
DDR4-DIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	32 (8 TB)		32 (4 TB)			16 (2 TB)		16 (1 TB)			8 (1 TB)		4 (128 GB)		
Festplattenlaufwerke bis zu:	12 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll oder 4 x 2,5 Zoll (hinten)	6 x 2,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll (hinten)	12 x 3,5 Zoll 26 x 2,5 Zoll	4 x 3,5 Zoll 12 x 2,5 Zoll	12 x 3,5 Zoll 24 x 2,5 Zoll	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll	8 x 3,5 Zoll 12 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll oder 8 x 2,5 Zoll	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll (hinten)	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll	8 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll	4 x 2,5 Zoll	6 x 2,5 Zoll	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll	4 x 3,5 Zoll 4 x 3,5 Zoll (verkabelt) 2 x 3,5 Zoll (verkabelt)
NVMe Laufwerke bis zu:	24	8	12	24	12	24	10	8	10	k. A.		4	6	k. A.	
Gen4 PCIe-Steckplätze bis zu:	8	8	3	8	3	2	1	5	3	2	3	3	5	3	2
Gen3 PCIe-Steckplätze bis zu:	k. A.					2	1	1	k. A.		1	k. A.			
Accelerator-Unterstützung bis zu:	2 x 300 W DW oder 4 x 150 W SW oder 6 x 75 W SW	4 x 150 W SW oder 4 x 300 W DW 2 x 75 W SW	3 x 75 W SW	3 x 300 W DW oder 6 x 75 W SW	3 x SW	4 x SW; 1 x DW; 1 x FPGA	1 x SW	k. A.				2 x 75 W SW	2 x 75 W oder 150 W SW 2 x 300 W DW	k. A.	
Rack-Höhe (U)	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
Integrierte Sicherheit	TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Gehäuseeingriffswarnung und sicherer Start als Standardsicherheit auf allen Racks. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Silicon Root of Trust, System Lockdown (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter) und System Erase auf allen Racks														

Rack-Server	R940	R940xa	R840	R740xd	R740	R740xd2	R640	R540	R440	R340	R240	
Wichtige Attribute	Leistungsstarke Performance	Extreme Beschleunigung	Beschleunigung der Datenanalyse	Maximierung der Storage Performance	Optimale Anwendungsleistung	Enterprise-Inhaltsserver	Leistung und Dichte	Ausgewogen und anpassbar	Scale-Out-Computing	Unternehmenswachstum beschleunigen	Compute leicht gemacht	
Ziel-Workloads	In-Memory-Datenbanken	GPU-Datenbank-Beschleunigung und Machine Learning	Datenintensive Workloads, HFT und dichte Virtualisierung	SDS, Serviceanbieter und Big Data-Server	VDI- und Cloud-Workloads	Medien-Streaming und SDS	Rechen- und Speicherkapazität für Rechenzentren mit hoher Dichte	Messaging und Virtualisierung	HPC, Web Tech und Skalierungs-Infrastruktur	ROBO-Produktivität und datenintensive Anwendungen	Workloads für kleine Unternehmen und Serviceanbieter	
Prozessortypen	4 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation				2 skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation				1 Intel Xeon E-2200, Intel Core i3®, Intel Pentium® oder Intel Celeron® Prozessor			
DDR4-DIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	48 (15,36 TB)			24 (7,68 TB)		16 (1 TB)	24 (7,68 TB)	16 (1 TB)		4 (64 GB)		
Festplattenlaufwerke bis:	24 x 2,5 Zoll	32 x 2,5 Zoll	26 x 2,5 Zoll	18 x 3,5 Zoll 32 x 2,5 Zoll	8 x 3,5 Zoll 16 x 2,5 Zoll	26 x 3,5 Zoll 16 x 3,5 Zoll + 10 x 2,5 Zoll ²	4 x 3,5 Zoll 12 x 2,5 Zoll	14 x 3,5 Zoll	4 x 3,5 Zoll 10 x 2,5 Zoll	4 x 3,5 Zoll 8 x 2,5 Zoll	4 x 3,5 Zoll 4 x 2,5 Zoll ²	
NVMe Laufwerke bis zu:	12	4.	24	k. A.		10	k. A.		4	k. A.		
Gen4 PCIe-Steckplätze bis zu:	k. A.											
Gen3 PCIe-Steckplätze bis zu:	13	12	6	8	5	3	5	2	2			
Accelerator-Unterstützung bis zu:	k. A.	4 x DW GPUs oder 4 x DW oder 8 x SW FPGAs	2 x DW GPUs oder 2 x SW oder DW FPGAs	3 x DW oder 6 x SW GPUs oder 3 x DW oder 4 x SW FPGAs		k. A.	1 x SW GPU oder 1 x SW FPGA	k. A.				
Rack-Höhe (U)	3	4.	2				1	2	1	1		
Integrierte Sicherheit	TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Gehäuseeingriffswarnung und sicherer Start als Standardsicherheit auf allen Racks. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Silicon Root of Trust, System Lockdown (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter) und System Erase auf allen Racks											

¹ Nicht alle Funktionen sind für alle Plattformen verfügbar.

² Laufwerke verwenden den hybriden Träger, um in den 3,5-Zoll-Laufwerkschacht zu passen. (Für R740xd2: eine Hybrid-Konfiguration ist mit bis zu 10 x 2,5-Zoll-SSDs verfügbar)

Cybersichere Architektur für Zero-Trust-IT-Umgebung und -Betrieb

Sicherheit ist in jede Phase des PowerEdge-Lebenszyklus integriert, einschließlich geschützter Lieferkette und Integritätsabsicherung von Werk zu Standort. Silicon-basierte Root of Trust Anchors, End-to-End-Startstabilität, während Multifaktor-Authentifizierung (MFA) und rollenbasierte Zugriffskontrollen vertrauenswürdige Vorgänge gewährleisten.

Nachhaltigkeit

Von recycelten Materialien in unseren Produkten und Verpackungen bis hin zu durchdachten, innovativen Optionen für Energieeffizienz – das PowerEdge-Portfolio wurde entwickelt, um Produkte herzustellen, bereitzustellen und zu recyceln, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Ihre Betriebskosten zu senken. Mit Dell Technologies erleichtern wir sogar die verantwortungsbewusste Stilllegung von veralteten Systemen.

Mehr Effizienz und schnellere Betriebsabläufe mit einer automatisierten Infrastruktur

Das Dell OpenManage Systems Management-Portfolio verringert die Komplexität der Verwaltung und des Schutzes der IT-Infrastruktur. Mithilfe der intuitiven End-to-End-Tools von Dell Technologies kann die IT eine sichere, integrierte Erfahrung bieten, indem Prozess- und Informationssilos reduziert werden, sodass die Konzentration auf das Wachstum des Unternehmens möglich wird. Das Dell OpenManage-Portfolio ist der Schlüssel für Ihre Innovations-Engine, die Sie durch Tools und Automatisierung dabei unterstützt, Ihre Technologieumgebung zu skalieren, zu managen und zu schützen.

Sorgenfrei mit Dell Technologies Services

Optimieren Sie Ihre PowerEdge-Server mit umfassenden Services, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, wo immer Sie sind. Beschleunigen Sie die Amortisierungszeit bei der Realisierung hoher KI-Anwendungsfälle mit [Professional Services for KI](#), wählen Sie aus maßgeschneiderten Bereitstellungsoptionen mit der [ProDeploy Suite](#), erhalten Sie proaktiven und vorausschauenden Support mit unserer [ProSupport Suite](#) und vieles mehr mit unseren Services, die an 170 Standorten verfügbar sind und von unseren über 60.000 MitarbeiterInnen und Partnern unterstützt werden.

Erfahren Sie mehr über PowerEdge-Server.



Weitere Informationen
zu Services für
PowerEdge-Server



Erfahren Sie mehr
zu unseren Systems
Management-Lösungen



Durchsuchen
Sie unsere
Ressourcenbibliothek



Folgen Sie
PowerEdge-Servern
auf X (ehemals Twitter)



Wenden Sie sich an einen
Dell Technologies Experten
für [Vertrieb oder Support](#)



Folgen Sie
PowerEdge-Servern
auf LinkedIn

Eine umfassende Liste finden Sie unter www.dell.com/PowerEdge. Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an Ihren Dell Vertriebsmitarbeiter, um weitere Informationen zu erhalten.

Copyright © Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Andere Markennamen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Inhaber.